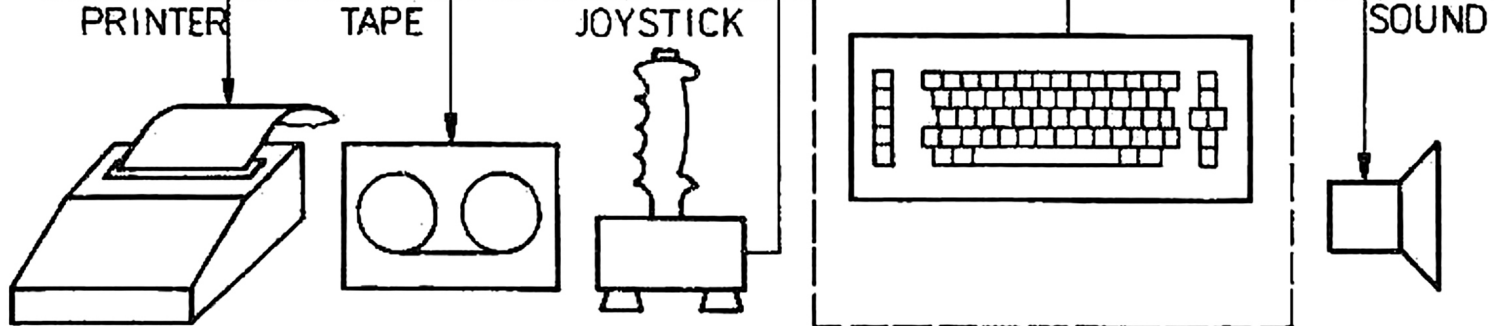
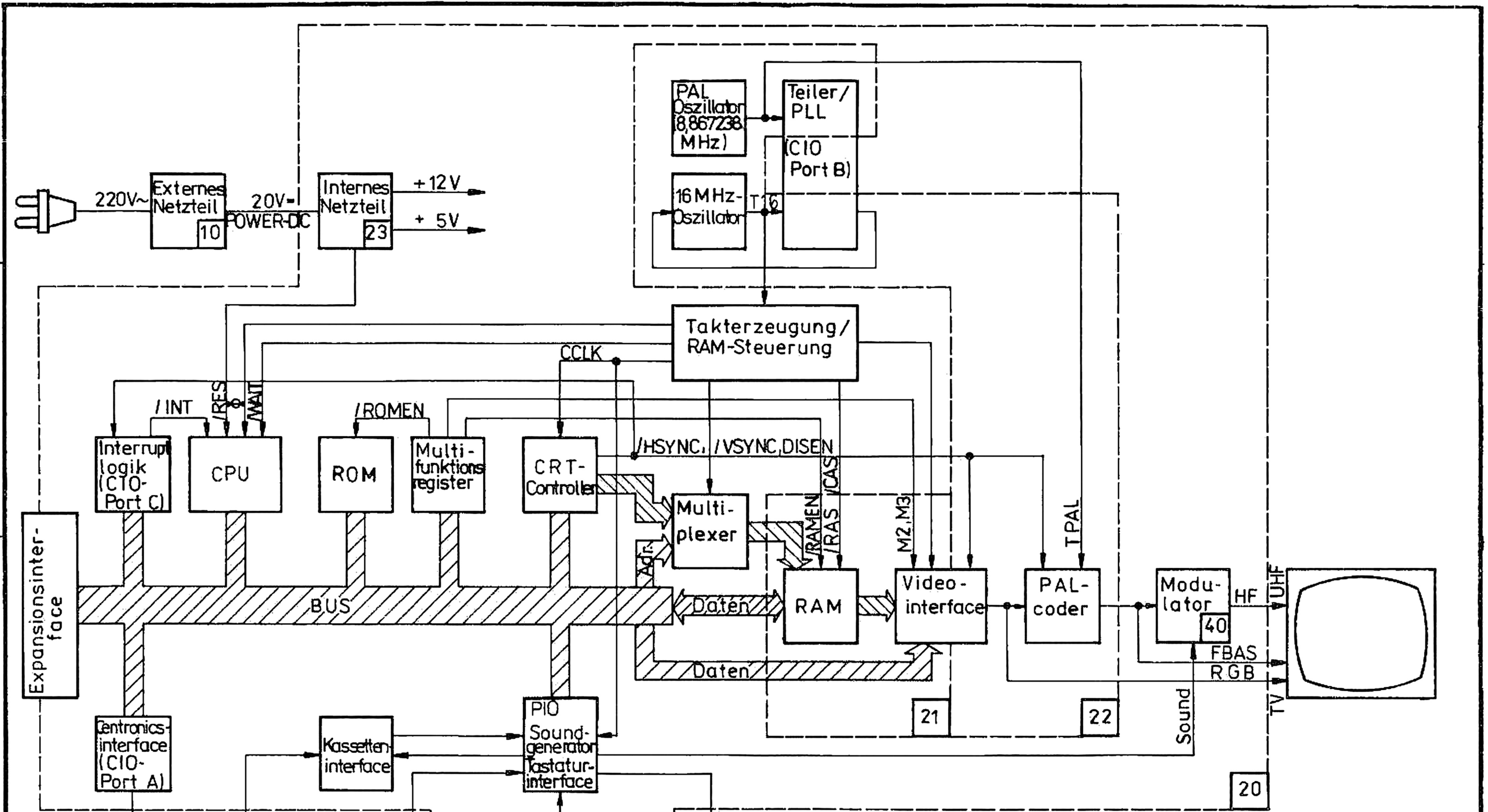


Bauelementennummer	Q1,001	entspricht	2001
-	101	-	2101
-	201	-	2201
-	301	-	2301

Durch \* gekennzeichnete Bauelemente werden nach dem Schalten bestückt, wodurch Leiterplatte vollst. entsteht

- V207 = VD 206
- V215 = VT 205
- V216 = VT 206
- V217 = VT 207
- V212 = VT 202
- V213 = VT 203
- V214 = VT 204

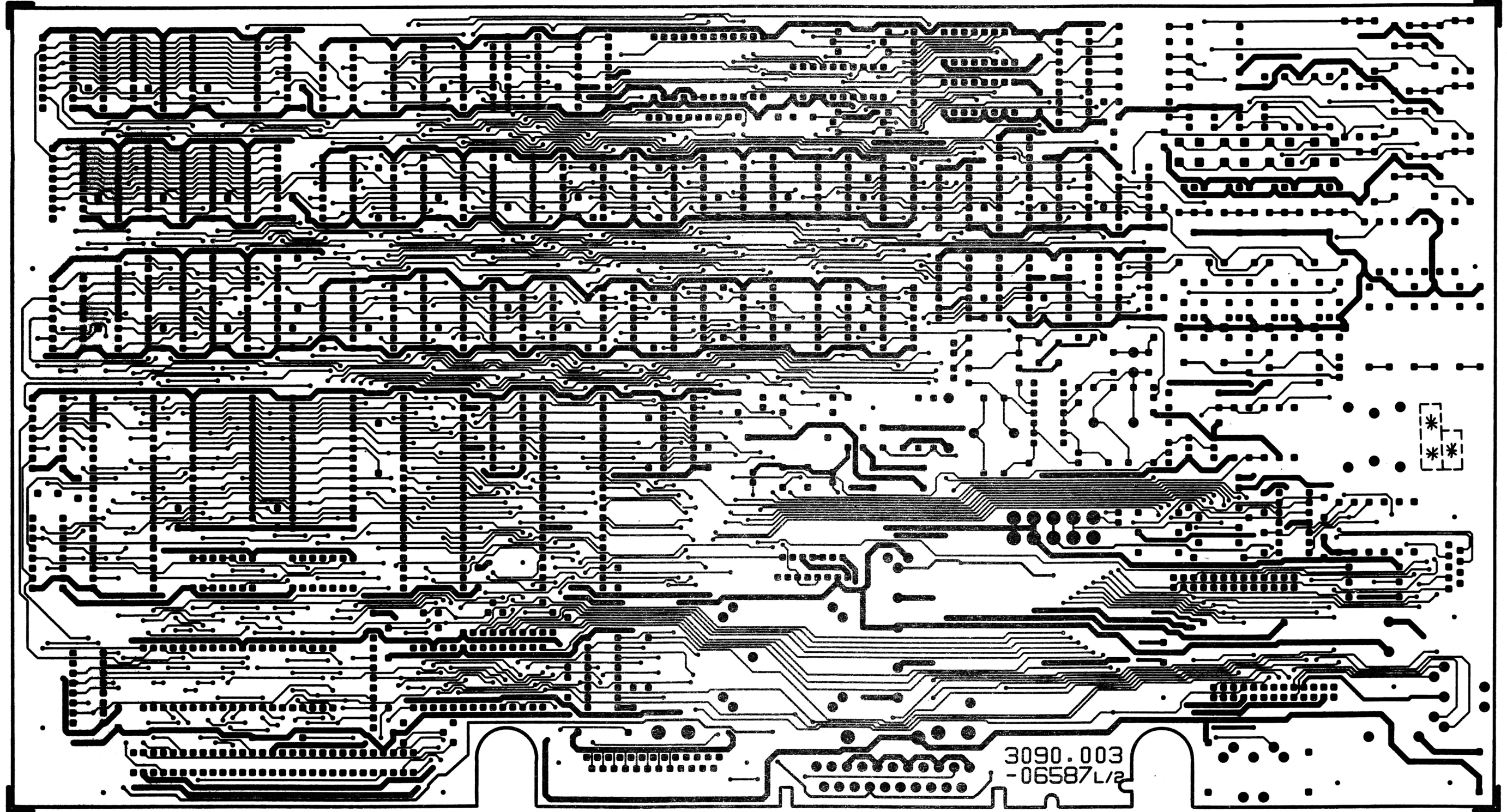
Leiterplatte, geschwält		21
Leiterplatte, vollst		
(Computer I)		
00	271089	
1989	2710	
5KTP 89 - 0408		m/h hausen
5KTP 89 - 0405		



				Halbzeug/Werkstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
				Benennung		Maßstab	
				KC compact		Bl. Anz. Bl. Nr.	
				Blockschaltbild		1   1	
				Zeichnungs-Nr.		Masse	
				5KCP__89__0200 (Bsb)		vab	
				Ers. für		Ers. durch	
						mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ mülhausen	
ÄZ	Mitteilung	Datum	Name				
19 89	Datum						
Bearb.	25.07.						
Konstr.	28.08.						
Technol.							
Stand.							



NEL 3090.003-06587 L/2 D53241

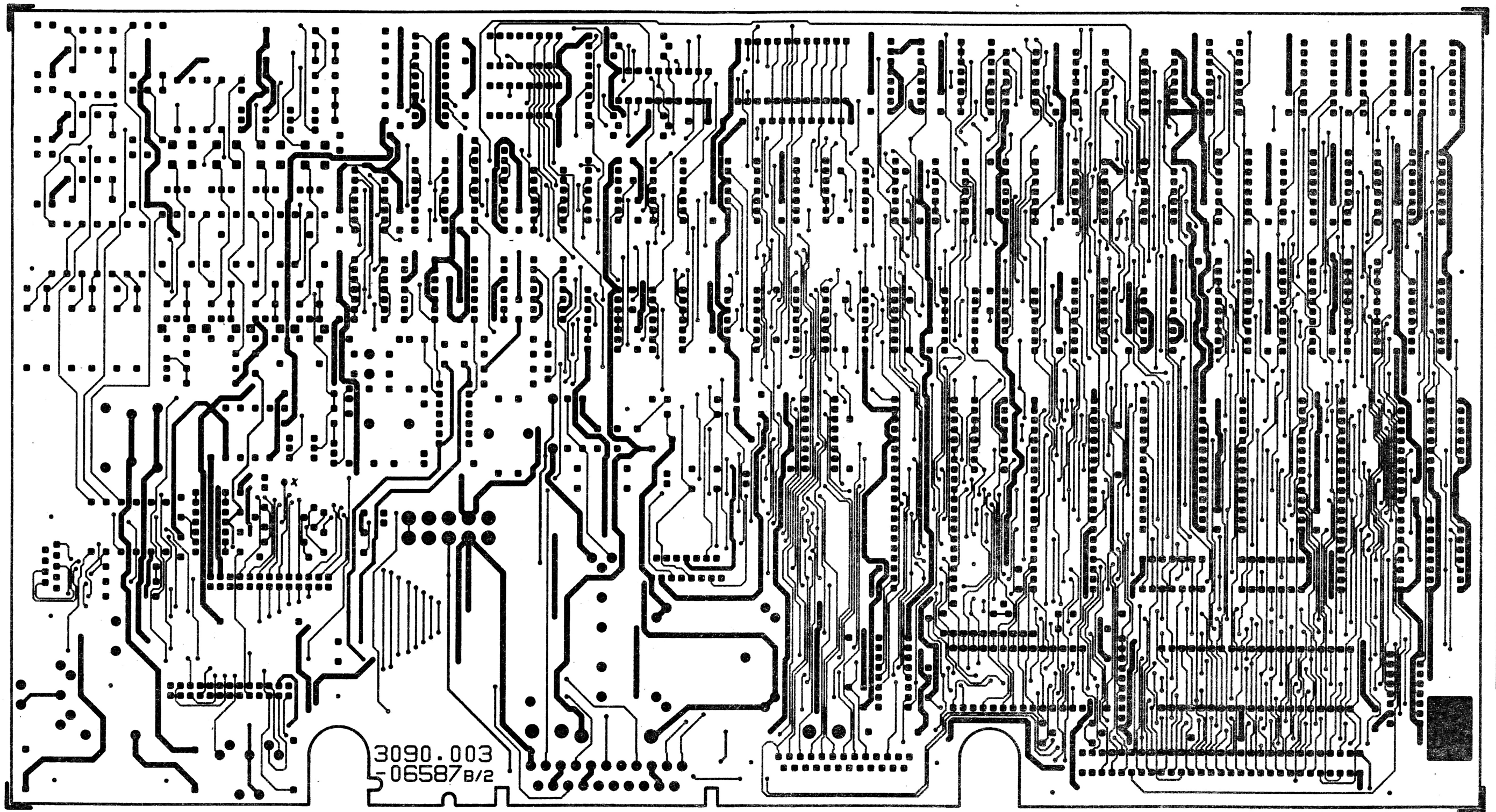


3090.003  
-06587 L/2

\* Fläche für Warenzeichen  
\*\* Fläche für Schlüssel - Nr.

(370 x 200)

				Herzang/Werkstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.		K2
						TGL 25016		
				Benennung		Maßstab		Bl.-Anz. Bl.-Nr.
				<b>LEITERPLATTE</b>		1:1		3
				Leiterbildzeichnung L		Masse		
a		26.6.	4	Zeichnungs-Nr.		5KCP_89_9540		VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ Mühlhausen
ÄZ	Mittelang	Datum	Name	(3090.003-06587)				
89		Datum	Name	Ers. für Orig. gl. Nr. v.		Ers. durch		
Bearb.		26.6.	K/4	5.3.89				
Konstr.								
Technol.								
Stand.								



3090.003  
- 06587 B/2

NEL 3090.003-06587 B/2 D53241

Y  
A

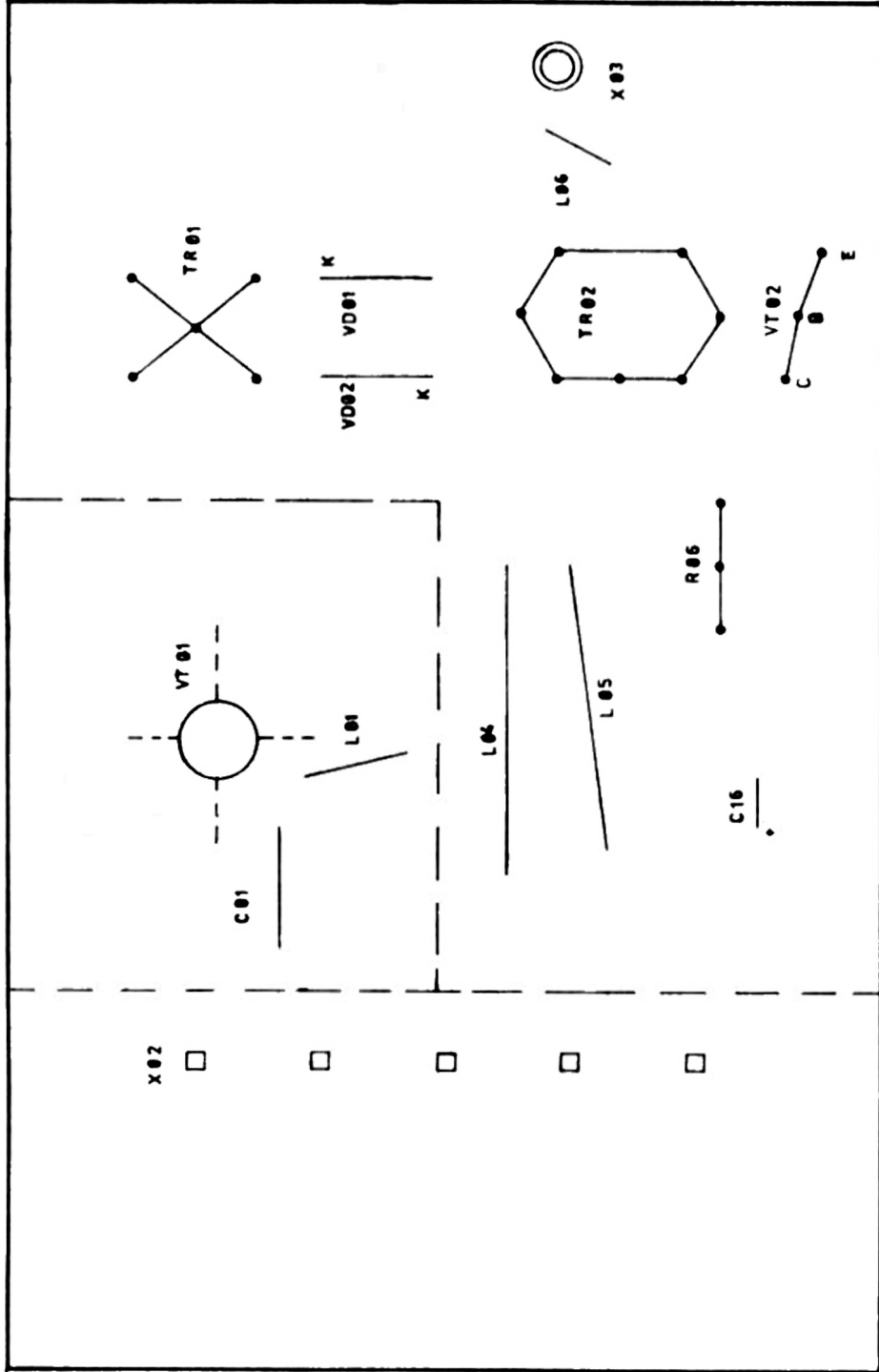
(1370 x 200)

\*Prüffläche ohne Bohrung

Cu-Fläche = 1,9 dm<sup>2</sup>

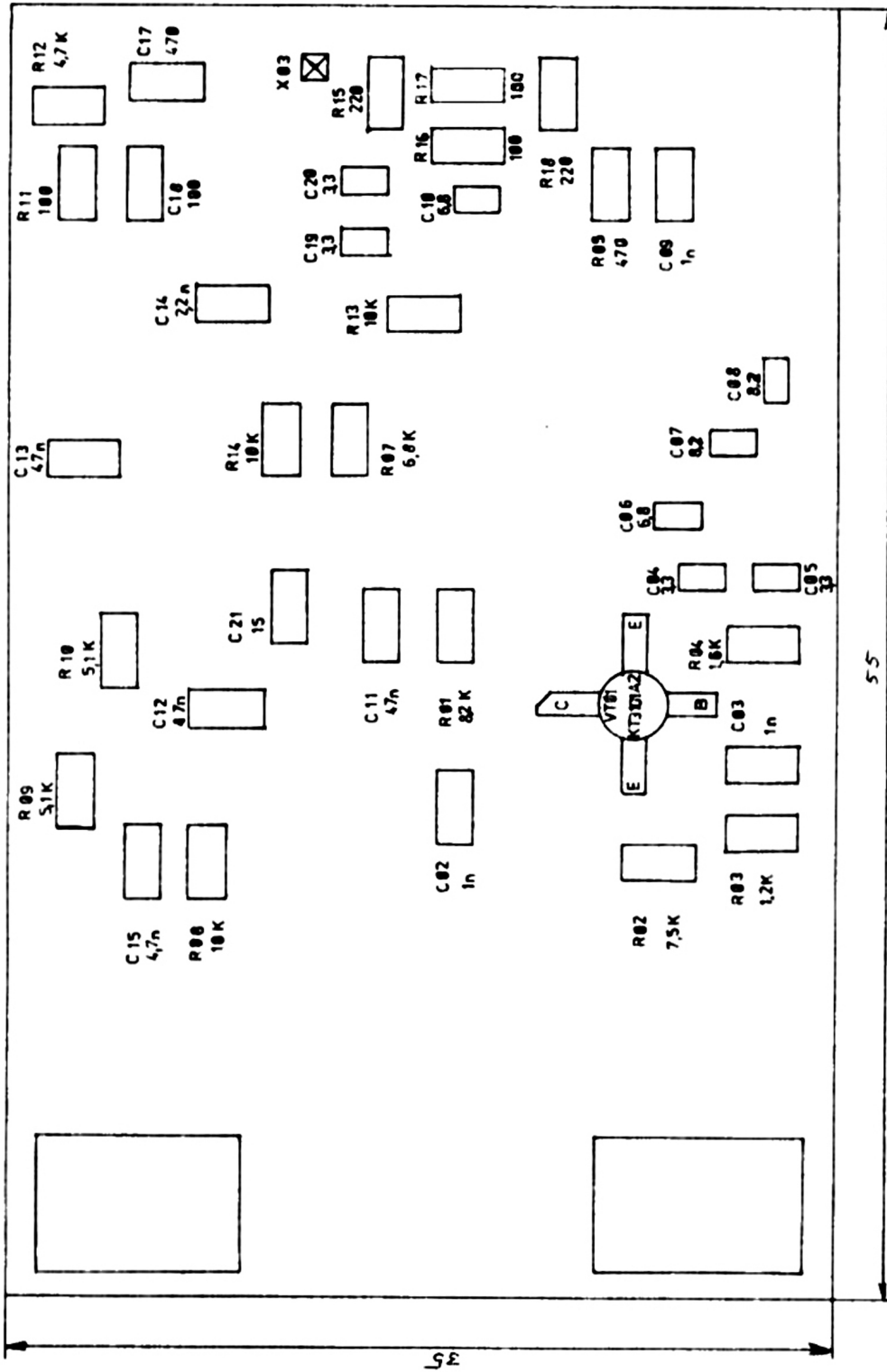
		Halbzeug/Workstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.		K2
				TGL 25016		
		Benennung		Maßstab		Bl.-Anz. Bl.-Nr.
		<b>LEITERPLATTE</b>		1:1		4
		Leiterbildzeichnung B		Masse		
a	26.6.	Zeichnungs-Nr. 5KCP_89_9540		VEB		
ÄZ	Mitteilung	Datum	Name	Mikroelektronik		
89				„Wilhelm Pieck“		
Bearb.	26.6.			Mühlhausen		
Konstr.						
Technol.						
Stand.		Ers. für Orig. gl. Nr. v. 5.3.89	Ers. durch			





- X 02
- 
- 
- 
- 

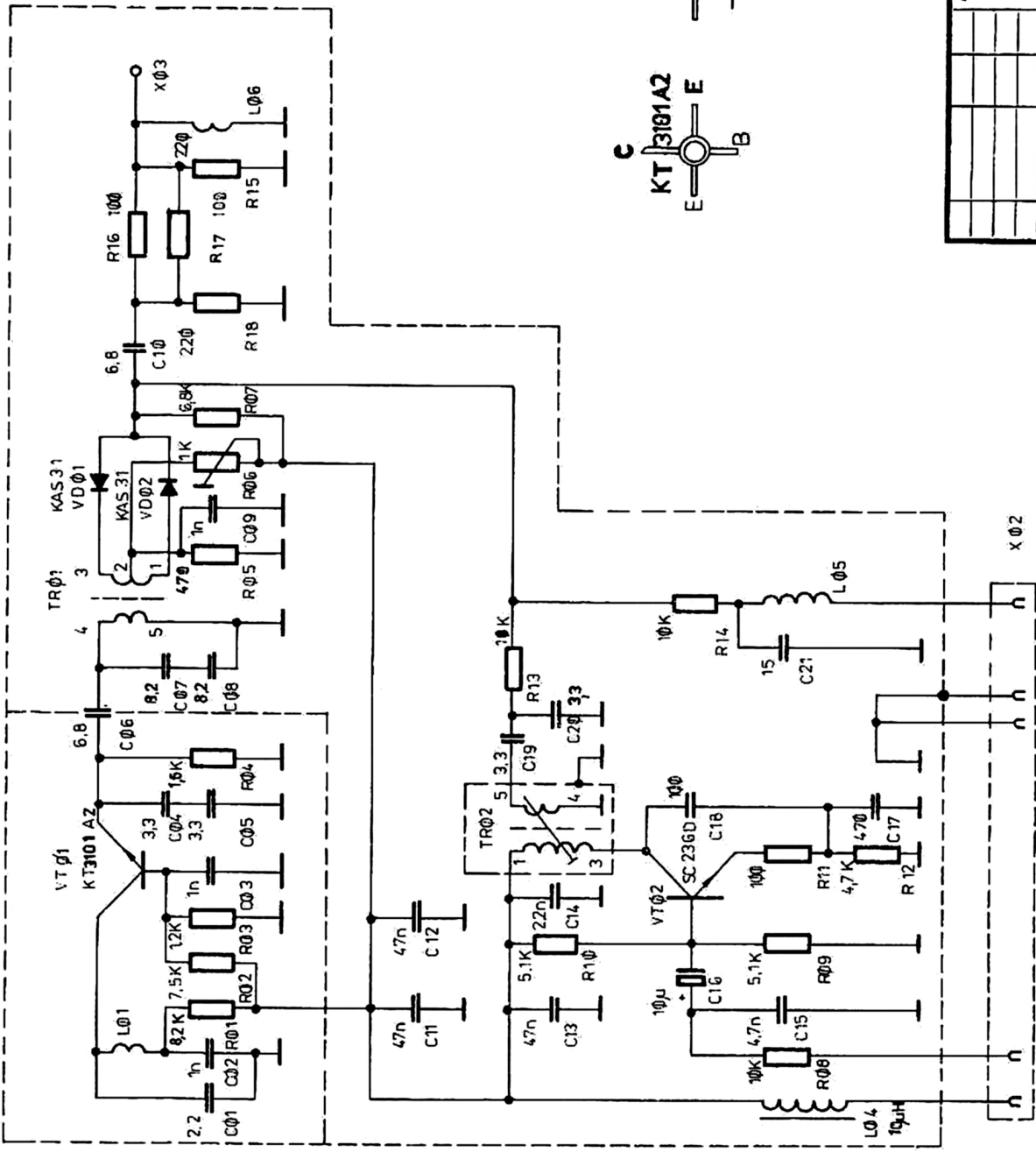
rel. Abm. für Maße oder Fertigung		rel. Abm. für Maße	
Maßstab 5:1		Maße	
Bezeichnung Leiterplatte vollst. (Modulator) Bestückungsplan (BE-Seite)			
Zeichnungs-Nr. 5KCP -- 89 --- 0506			
Erz. Nr.		Erz. durch	
AZ	Aufstellung	Datum	Name
1989		18.9	
Bearb.		18.9	
Technol.			
Stand.			



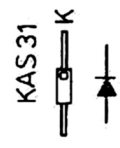
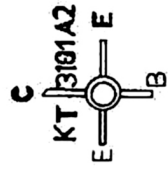
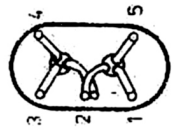
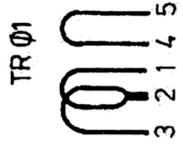
Zust. / Anz. Baugr.		rel. Anz. für Maße ohne Toleranzang.	
		Maßstab 5:1	
		Masse	
Bauart Leiterplatte vollst. (Modulator)			
Bestückungsplan (Leiterseite)			
Zeichnungs-Nr. 5KCP--89---0506			
AZ		Mittelung	Defnum Name
1989	Defnum	18.9	Name
Bearb.	18.9		80
Kontroll.	18.9		80
Fertigst.			
Stand.			

Herstellung/Werkstoff		Ers. Nr.	
		Ers. Nr.	



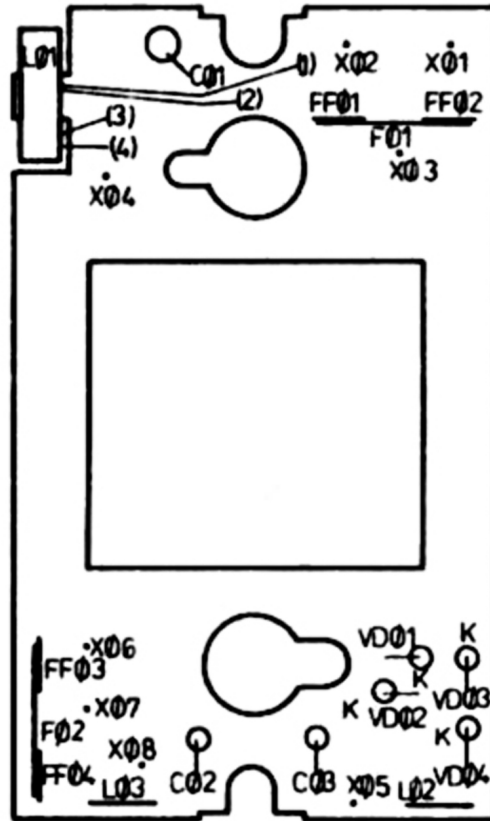


UHF



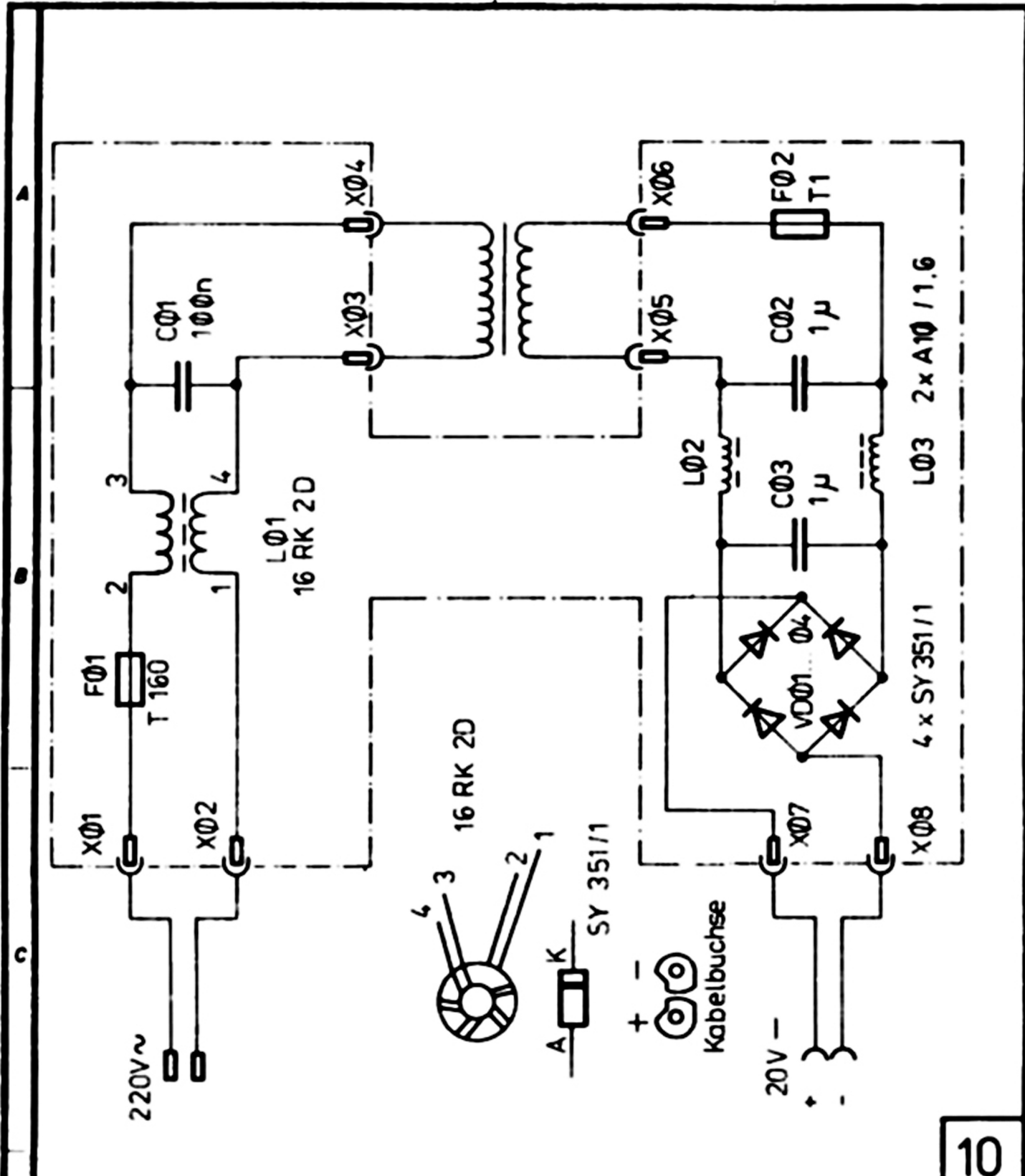
+ 12V Sound A

Halbleiter/Marken		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
Benennung		Modulab	W.Aus.BL/ab
Leiterplatte; vollst. (Modulator)		Masse	
Stromlaufplan		Menge	
Zeichnungs-Nr.			
5 KCP_89_0506 (Sp)			
Ers. für		Ers. durch	
AZ	Mitteilung	Datum	Name
1989			
Bearb.	31.03	VO	
Konstr.	15.03		
Technol.			
Stand.			



C01... C03 und VD01 ...VD04  
stehend bestückt

				Halbzeug/Werkstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
				Benennung		Massefab	
				Leiterplatte, geschwältt (Netzteil)		Blatt Nr.	
				Zeichnungs-Nr.		Masse	
				5KCP__89__0460		veb mikroelektronik „wilhelm pleck“ müh:hausen	
				Era. für		Era. durch	
				1989			
				Mittellung		Datum	
				13.7		Name	
				Konstr.		11.7.	
				Technol.			
				Stand			

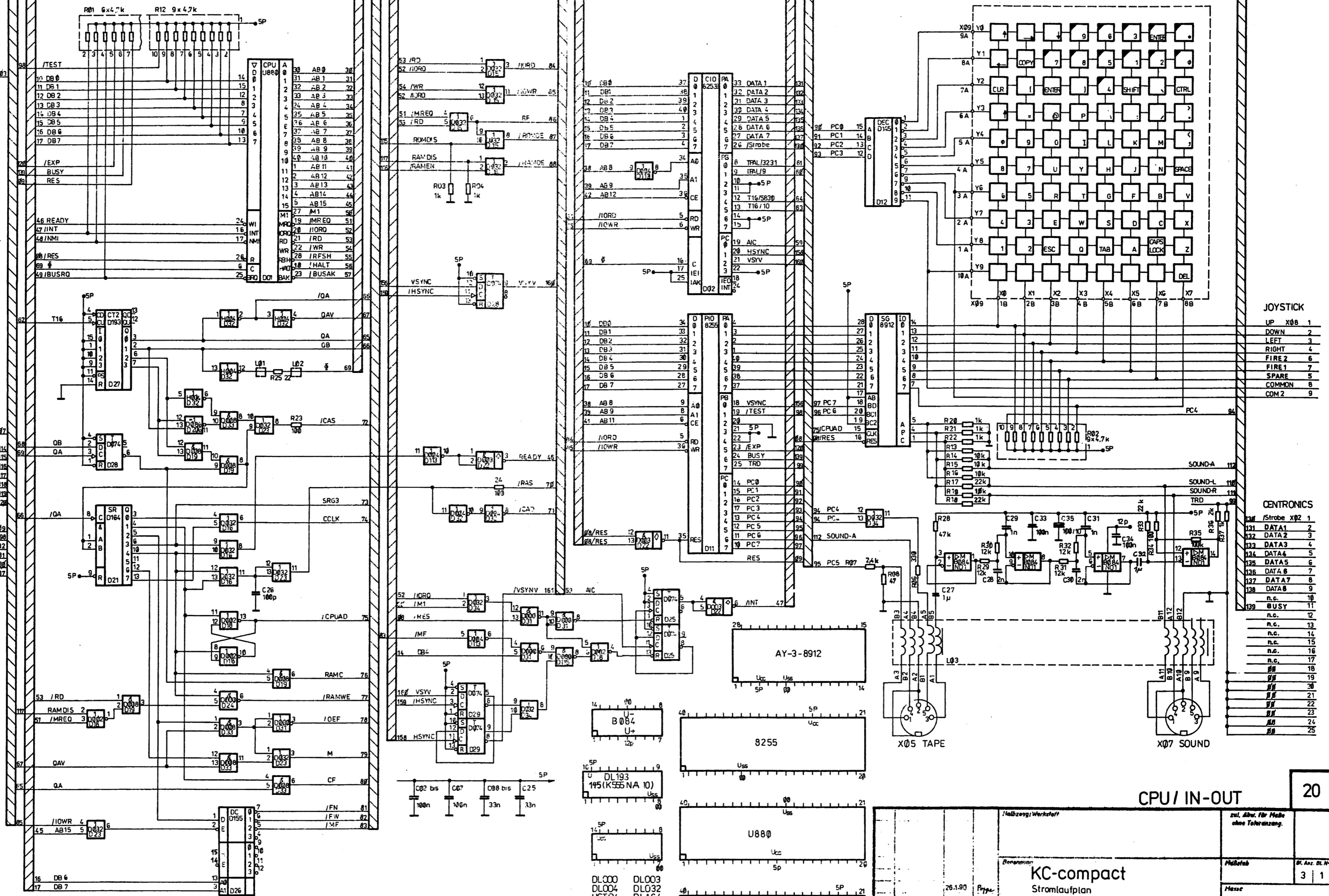


10

				Maßstab/Werkstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
				Benennung		Maßstab	
				Netzteil Stromlaufplan		Blatt Nr.	
				Zeichnungs-Nr.		Masse	
				5 KCP__ 89__ 0350(Sp)		VDO mikroelektronik „wilhelm plöck“ müh'hausen	
				Ers. für		Ers. durch	
				AZ			
				1989			
				Boarb.			
				Konstr.			
				Technol.			
				Stand			

EXPANSION

1A	UR	12p
2A	SOUND-A112	112
3A	AB15	45
4A	AB14	44
4A	AB13	43
4A	AB12	42
5A	AB11	41
5A	AB10	40
6A	AB9	39
6A	AB8	38
7A	AB7	37
7A	AB6	36
8A	AB5	35
8A	AB4	34
9A	AB3	33
9A	AB2	32
10A	AB1	31
11A	DB7	17
11A	DB6	16
12A	DB5	15
12A	DB4	14
13A	DB3	13
14A	DB1	11
15A	SP	01
15A	/MREQ	51
16A	/M1	50
16A	/RFSH	55
17A	/IORO	52
17A	/RD	53
18A	/WR	54
18A	/HALT	56
19A	/INT	47
19A	/NMI	48
20A	/BUSRQ	49
21A	READY	46
21A	/BUSPSET	72
22A	/RES	80
22A	/ROMEN	114
23A	/ROMDIS	115
23A	/RAMEN	116
24A	/RAMDIS	117
24A	CURSOR	118
25A	LPEN	119
25A	/EXP	120
26A	00	69
27A	FBAS	109
27A	/TEST	98
28A	DATA 2	132
28A	DATA 1	131
29A	/Strobe	130
29A	DATA 7	137



JOYSTICK

UP	X08	1
DOWN		2
LEFT		3
RIGHT		4
FIRE 2		6
FIRE 1		7
SPARE		8
COMMON		8
COM 2		9

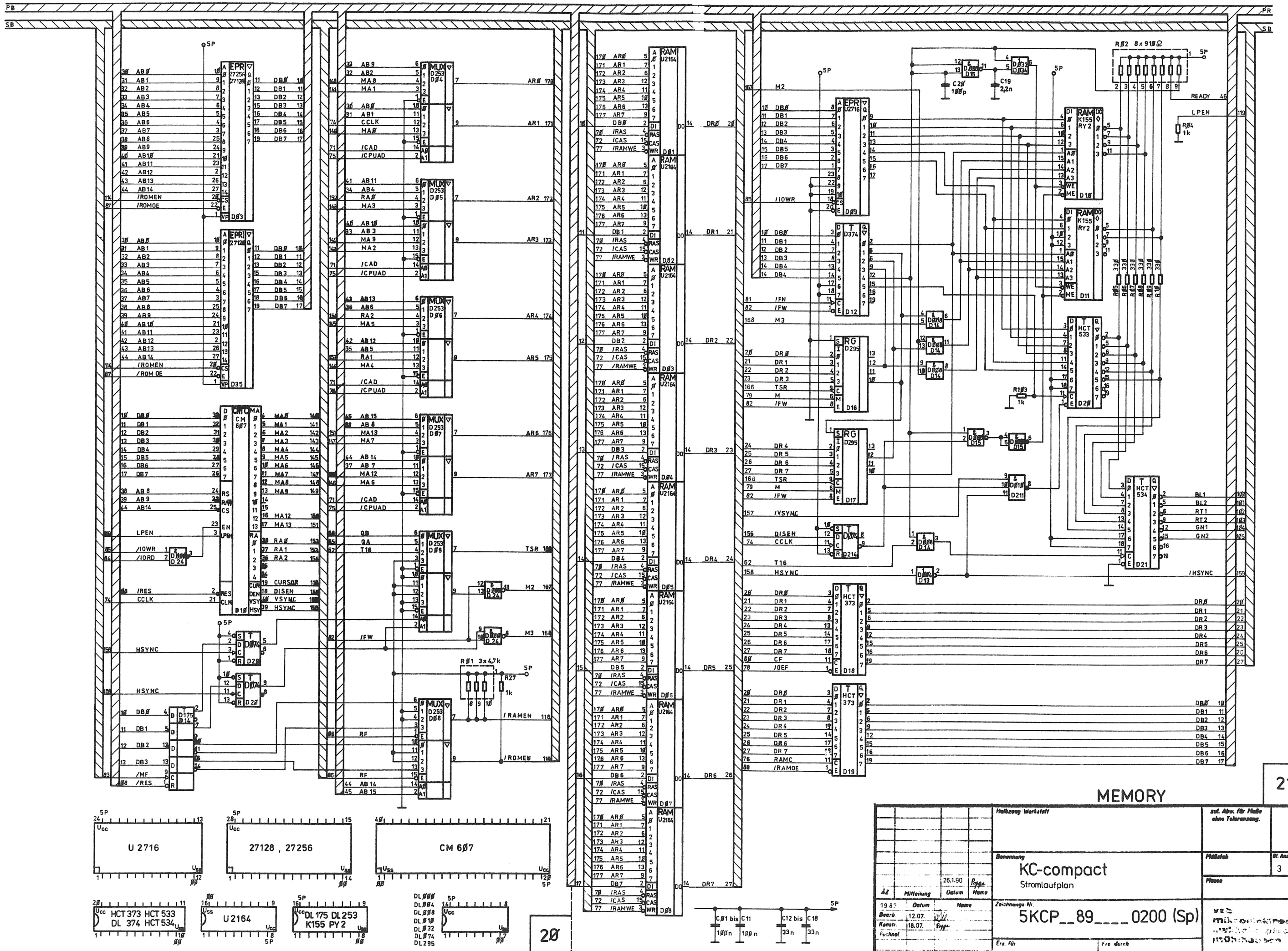
CENTRONICS

130	/Strobe	X02	1
131	DATA 1		2
132	DATA 2		3
133	DATA 3		4
134	DATA 4		5
135	DATA 5		6
136	DATA 6		7
137	DATA 7		8
138	DATA 8		9
n.c.			10
n.c.			11
n.c.			12
n.c.			13
n.c.			14
n.c.			15
n.c.			16
n.c.			17
00			18
00			19
00			20
00			21
00			22
00			23
00			24
00			25

CPU / IN-OUT 20

<p>U880</p> <p>U82536</p>		<p>Halbzeug/Werkstatt</p> <p>zur Abw. für Maße ohne Toleranzang.</p>	
<p>DL000 DL003</p> <p>DL004 DL032</p> <p>HCT04 DL164</p> <p>DL002</p> <p>DL008</p> <p>DL086</p>		<p>Bezeichnung: <b>KC-compact</b></p> <p>Strömungsplan</p>	
<p>1989 Datum</p> <p>19.7.89</p> <p>25.7.89</p>		<p>Blatt Nr. 3   1</p> <p>Hersteller: <b>vab mikroelektronik</b></p> <p>Werk: <b>Waldheim pickel</b></p> <p>München</p>	





MEMORY

Halbzeug Werkstoff		zul. Abw. für Maße ohne Toleranzang.	
Benennung		Herstellung	
KC-compact		Bl. Aus. Bl. Nr.	
Stromlaufplan		3   2	
Phase			
ÄZ	Mitteilung	Datum	Page
19.83		26.1.90	
Beerb	12.07.		
Konatr	18.07.		
Tschuel			
Zeichnungs-Nr.		vz	
5KCP_89_0200 (Sp)		19.07.1989	
Ers. für		Frei durch	

